

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称公司）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准翰博高新材料（合肥）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]1300 号）核准，公司 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,000,000 股，发行价为 48.47 元/股，募集资金总额为人民币 48,470 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 4,351.60 万元（不含税）后，实际募集资金金额为 44,118.40 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 17 日到账。上述资金到账情况业经已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 20 日出具天职业字[2020]32804 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：公司累计直接投入募集资金项目 36,921.54 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 7,196.86 万元，募集资金专用账户利息收入 915.67 万元，募集资金专户 2023 年 6 月 30 日结余合计为 8,112.53 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

本公司董事会批准开设了 中国建设银行合肥青年路支行 34050145470800001828、中

国银行股份有限公司重庆北碚支行 111674531230、中国银行股份有限公司重庆北碚支行 113074526840 三个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

2023 年 5 月 9 日，公司、公司之子公司博讯光电科技（合肥）有限公司与中国建设银行股份有限公司合肥青年路支行（以下简称“青年路支行”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在青年路支行开设募集资金专项账户（账号：34050145470800001828）。

2023 年 5 月 9 日，公司、公司之子公司重庆翰博显示科技有限公司、重庆翰博显示科技研发中心有限公司分别与中国银行股份有限公司重庆北碚支行（以下简称“北碚支行”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在北碚支行开设募集资金专项账户（账号：111674531230、113074526840）。

截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国建设银行合肥青年路支行	34050145470800001828	4943.62
中国银行股份有限公司重庆水土支行	111674531230	2668.51
中国银行股份有限公司重庆水土支行	113074526840	500.40
合计		8112.53

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 36,921.54 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内不存在变更募投项目实施地点、实施方式的情况。

前期变更募投项目实施地点、实施方式的情况如下：公司于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金使用方式的议案》：根据募

集资金投资项目实施的客观需要，为了简化募集资金投入程序、加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，在募集资金投资项目实施主体、项目用途等不变的情况下，公司变更募集资金使用方式，将募集资金 141,924,000 元（该金额不包含已产生的利息）以增资形式用于实施背光源智能制造及相关配套设施建设项目，暨对博讯光电科技（合肥）有限公司进行增资。

（三）募投项目先期投入及置换情况

不适用。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（五）节余募集资金使用情况

不适用。

（六）超募资金使用情况

不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。

前期变更募集资金投资项目的情况如下：公司于 2021 年 3 月 26 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，于 2021 年 4 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司 2021 年 3 月 29 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《翰博高新材料（合肥）股份有限公司变更募集资金用途公告》及相关公告；公司决定将原募集资金投资项目“有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂

（二期）项目”暂未使用的募集资金 140,920,398.41 元(其中本金 140,000,000 元利息 920,398.41 元)用于本次新增募投项目“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”和“重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目”。

截至 2023 年 6 月 30 日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1: 募集资金使用情况对照表

附表2: 变更募集资金投资项目情况表

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		48,470				本年度投入募集资金总额				2837.417
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额		14,092.04				已累计投入募集资金总额				36,921.53
累计变更用途的募集资金总额比例		29.07%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目	是	8,000.00	8,000.00	681.55	5428.22	67.85%	2023-12-31	不适用	不适用	无
2、重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目	是	6,092.04	6,092.04	865.86	5786.51	94.98%	2023-12-31	不适用	不适用	无
3、背光源智能制造及相关配套设施建设项目	否	14,192.40	14,192.40	1290.00	9753.24	68.72%	2023-12-31	不适用	不适用	无
4、补充流动资金	否	15,926.00	15,926.00	-	15,953.56	100.17%	不适用	不适用	不适用	无
承诺投资项目小计		44,210.44	44,210.44	2837.41	36921.53					
合计		44,210.44	44,210.44	2837.41	36921.53					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	公司于 2022 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》：受行业周期性以及宏观经济环境影响，结合公司实际经营情况，经审慎研究，公司重新调整项目建设规划，适当放缓了项目的实施进度，将项目预计达到可使用状态的时间调整至 2023 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金使用方式的议案》：根据募集资金投资项目实施的客观需要，为了简化募集资金投入程序、加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，在募集资金投资项目实施主体、项目用途等不变的情况下，公司变更募集资金使用方式，将募集资金 141,924,000 元（该金额不包含已产生的利息）以增资形式用于实施背光源智能制造及相关配套设施建设项目，暨对博讯光电科技（合肥）有限公司进行增资。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	银行存款账户结余
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度%(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目	有机发光半导体(OLED)制造装置零部件	8,000.00	681.55	5428.22	67.85%	2023-12	不适用	不适用	不适用
重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目	剥离、精密再生及热喷涂(二期)	6,092.04	865.856	5786.51	94.98%	2023-12	不适用	不适用	不适用
合计	-	14,092.04	4,913.72	9,667.32	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)					为应对日益变化的市场环境,公司将用新项目扩大公司产能,延伸产业链条,提升公司科研实力,增强公司经营能力和竞争力。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					不适用				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				

注:公司于2021年3月26日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议,于2021年4月13日召开2021年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》:截至2021年2月28日,本次涉及变更的募集资金总额为原“有机发光半导体(OLED)制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂(二期)项目暂未使用的募集资金140,920,398.41元(其中本金140,000,000元,利息920,398.41元)。变更的资金拟用投资建设重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目、重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目。